



Editorial

Chers lecteurs/lectrices,

L'activité bat son plein !

En effet, la promotion de l'évènement MiNaPAD2022 a démarré à 2 mois de son ouverture le 23 Juin à Grenoble. Les exposants ont répondu présent, le programme est équilibré : nous vous attendons.

L'appel à papiers pour l'évènement POWER2022 vient de démarrer pour une journée de conférence à Tours.

Enfin, THERMAL est définitivement planifié au Futuroscope en 2023. L'appel à papiers va être initié début Mai ainsi que la commercialisation des stands dans un nouvel environnement.

Mais n'oublions pas les autres évènements européens tel que ESTC 2022 qui se déroulera en Roumanie dans la ville de Sibiu les 13 et 16 Septembre ; il y aura la réunion IMAPS Europe regroupant tous les chapters IMAPS – en distanciel ou présentiel mixte, l'avenir nous le dira !

Nous avons reçu notre bilan comptable pour l'année 2021. Je vous rappelle que le seul évènement en 2021 a été POWER qui a montré un bon redémarrage des conférences. Mais également, le départ à la retraite de Florence Vireton et la fermeture du bureau à l'espace Hamelin. L'association montre un déficit de 4751 Euros avec un chiffre d'affaires de 33940 Euros ; C'est un bilan de transition compte tenu de tout ce que nous avons réalisé en 2021 ! Je porte beaucoup d'optimisme pour cette année dont vous, adhérents, êtes les premiers acteurs de part votre adhésion et votre participation aux évènements en tant qu'exposant, orateur, participant, membre du comité technique.

Sur le renouvellement des adhésions pour l'année 2022, je tiens à vous remercier. Vous êtes 73 sur un total de 105 adhérents en 2021 ; la relance est à poursuivre ! Il est à noter 10 nouveaux adhérents et cela est encourageant. De plus, nous comptons 3 retraités fidèles qui bénéficient d'une tarification spéciale à nos évènements, dont l'un d'eux a fait un don de soutien à l'IMAPS.

Alexandre VAL

"Everything in electronics between the chip and the system" (ISHM – Une définition du Packaging)

Calendrier IMAPS France 2022

Comité directeur 22 Juin 2022 - Grenoble
9^{ème} Forum MiNaPAD 23 et 24 Juin 2022 – Grenoble Tarifs promotionnels jusqu'au 17 Mai
Assemblée Générale Septembre 2022
13^{ème} From Nano to Macro Power Electronics & Packaging Workshop 24 Novembre 2022 – Tours
16^{ème} European Advanced Technology workshop on Micro packaging and Thermal Management 8-9 Mars 2023 – Poitiers Futuroscope

Prochaine édition : Juillet 2022

Review from the Chapters of IMAPS- Europe



<https://imapseurope.org/>



CICMT 2022

International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies (CICMT), [CICMT 2022 - IMAPS Europe](#)

13-15 July 2022

Austrian Economic Chambers

Vienna, Austria

www.cicmt.org

The Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies (CICMT) conference brings together a diverse set of disciplines to share experiences and promote opportunities to accelerate research, development and the application of ceramic interconnect and ceramic microsystems technologies. This international conference features ceramic technology for both microsystems and interconnect applications in a multi-track technical program.



HiTEN 2022

International Conference and Exhibition on High Temperature Electronics Network (HiTEN 2022)

July 18-20, 2022

St. Anne's College in the University of Oxford
Oxford, United Kingdom

www.imaps.org/hiten

13th -16th September 2022: [ESTC 2022](#)

The **Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC)** is a premier international event in the field of electronics packaging and system integration. The conference is organized every two years in Europe and is supported by IEEE-EPS in association with IMAPS-Europe. The 9th ESTC will be taking place in **Sibiu, Romania**. Placed in the middle of Romania, surrounded by the high Carpathian Mountains and Cibin river, Sibiu is a citadel of the European electronics industry and represents a place where culture, landscape, gastronomy and profession merge in a friendly pleasant environment.

11th - 14th of September 2023: [EMPC 2023 – 24th European Microelectronics Packaging Conference 11-14 September 2023 – iMAPS-UK & IMAPS-Europe](#)

EMPC 2023 will take place at the **Genome Centre, Cambridge, United Kingdom**

The event will present the best of microelectronics packaging and interconnection technologies, providing world-class coverage of technological innovation in the microelectronics and packaging field with contributions from both industry and academia.

Bilan comptable 2021

Comme vous le savez, nous n'avons pas encore tenu l'assemblée générale de l'association, qui a traditionnellement lieu en septembre. Nous tenons cependant à vous présenter le bilan comptable 2021 déjà disponible.

Les résultats financiers :

Pour 2020, les données économiques se décomposent de la façon suivante : pour rappels

Charges d'exploitation : 60 326 Euros pour 2020

Fonctionnement Hamelin : 14 539 Euros

Charges salariales : 45 651 Euros

Allocation d'activité partielle : 10 910 Euros

Autres Frais (gestion, TVA ...) : 11 046 Euros

Chiffre d'affaires : 88 261 Euros

Soit un résultat d'exploitation de -9 878 Euros

(Nous avons profité de la conjoncture défavorable à notre activité pour épurer notre comptabilité. Ainsi des vieilles créances IMAPS US ont été passées en charges exceptionnelles -8 199€).

). Le niveau du fonds de roulement s'est maintenu autour de 95 000 Euros.

Pour 2021, nous avons géré le départ à la retraite de Florence. En effet les membres du bureau (Alexandre Val, Jean-Yves Soulier, Bruno Levrier) ont repris les activités commerciales ; c'est nouveau et en tant que bénévoles nous acceptons de prendre cette charge de travail à la condition d'avoir dans la perspective de 2022 des candidats pour le renouvellement du bureau.

Le bureau physique de l'espace Hamelin a été rendu et remplacé par un bureau virtuel via la domiciliation qui reste à la même adresse postale !

Nous sommes passé d'un montant de charges fixes de 5700€ par mois à 820€ !

Les données économiques se décomposent de la façon suivante :

Charges d'exploitation : 38 691 Euros pour 2021

Fonctionnement Hamelin : 11 314 Euros

Charges salariales : 26 266 Euros

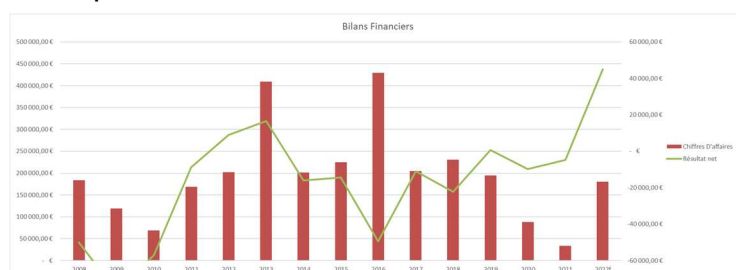
Autres Frais (TVA ...) : 1 111 Euros

Chiffre d'affaires : 33 940 Euros

Soit un résultat d'exploitation de -4 751 Euros. Le niveau du fonds de roulement s'est maintenu autour de 80 000 Euros.

Grâce à la confiance de nos exposants, notre trésorerie a été maintenue car nous avons remboursé 30% des réservations de stands de MiNaPAD 2020/2021 !

Mais il faut rester conscient que cette avance se retrouvera dans nos résultats 2022 ; et c'est bien pour cela que nous aurons besoin d'un regain de participation dans nos événements : MiNaPAD 2022, Power 2022 et Thermal 2023. Graphiquement, on constate que le résultat net s'améliore depuis 2018 et que 2022 devrait être une année de reconquête – le prévisionnel est peut-être optimiste !



Evolution Chiffre d'affaires (échelle gauche) et Bénéfices (échelle droite) 2008 à 2022

	Chiffres d'affaires	Résultat d'exploitation
2017	81 354 €	-32 236 €
2018	149 065 €	-22 353 €
2019	194 402 €	660 €
2020	88 261 €	-9 878 €
2021	33 940 €	-4751 €
2022f	180 000 €	45 000 €

Pour 2022, nous restons sur une structure allégée et bénévole.

Nous tenions à vous expliquer ce côté financier de l'association afin de vous assurer de notre bonne gestion et de notre souci de travailler à recouvrer une santé financière permettant d'envisager pour 2023 – 2024 un portage salarial pour la gestion de l'évènementiel !

N'hésitez donc pas à promouvoir notre association auprès de vos contacts, des étudiants et jeunes (ou moins jeunes) ingénieurs qui pourront s'épanouir dans cette activité du packaging électronique.

Alexandre Val – Président

9ème Forum MiNaPAD 2022

23 et 24 Juin



A deux mois du **9^{ème} forum MiNaPAD 2022**, nous avons un programme proposant **26 papiers** qui couvrent notre domaine d'activité.

Il est structuré avec **6 sessions** le jeudi 23 Juin et **4 sessions** le vendredi 24 Juin, ce qui fait 2 journées assez denses en contenu.

Pour le moment **2 keynotes** sont prévus :

ASE group, CP HUNG Vice president of corporate R&D, le 23 Juin en Ouverture.

STMicroelectronics, Jérôme LOPEZ, Senior Expert Microelectronics Packaging, le 24 Juin.

Le jeudi 23 Juin, un dîner est organisé aux Jardins de Sainte Cécile avec, pour vous accueillir, un trio de musiciens...je ne vous en dit pas plus !

Nous avons optimisé notre tarification pour rendre l'évènement plus attractif ; je vous invite à consulter cette grille tarifaire dans le programme que vous déjà reçu ou bien sur notre site ([MiNaPAD 2022 – IMAPS France \(imaps europe.org\)](http://MiNaPAD_2022_-_IMAPS_France(imaps europe.org))).

Tarif promotionnel (Early Bird)
Jusqu'au 17 Mai
Profites-en !

L'entrée sera gratuite pour les étudiants, doctorants s'inscrivant à l'une des deux journées ainsi que leur encadrant pédagogique.

Et **31 exposants** qui est un excellent résultat et même une performance. Nous mettons tout en place pour accueillir nos exposants afin que la

relation exposants et participants se déroule de façon optimale.

Booth number	Company name
1	ASE group
2	DISCO Hi-TEC Europe
3	ACCELONIX
4	BESI
5 & 6	DAVUM
7	Specialty Coating Systems
8	MST
9	TAIPRO ENGINEERING
10	ELECTRON MEC
11	BT Electronics and Poly Dispensing Systems
12	KYOCERA
13	METRONELEC
14	NTK Technical Ceramics
15	MINAPACK
16	AEMTEC
17	SET
18	SERMA Microelectronics
19	NANOTEC
20	ISP System
21	Plasma-Therm and CORIAL
22	TELEDYNE E2V
23	HYBRID SA
24	AMKOR
25	JCET
26	ONTOS Equipment Systems
27	IMEC
28 & 29	CEA LETI
30	CAPLINQ - HENKEL
31	PROTAVIC - PROTEX
32	PACTECH
33	KOH YOUNG

Comme je vous l'avais signalé lors de la dernière édition de notre journal, l'évènement MiNaPAD peut être l'occasion, pour les participants, d'organiser en parallèle des réunions d'avancement de projets, européens par exemple. Cela est possible à partir du 22 Juin après-midi jusqu'au 24 Juin fin d'après-midi. N'hésitez à me contacter pour plus de précision sur les modalités.

Dates clés MiNaPAD 2022

Ouverture des inscriptions : Mi-Avril 2022

Catalogue en ligne : Fin Avril 2022

Alexandre VAL, General Chairman

13^{ème} Forum Power 2021
From Nano to Macro Power
Electronics & Packaging Workshop
24 Novembre
Greman, Université de Tours (37)



Comité Technique

Chairman :

Stéphane BELLENGER (ST Microelectronics Grenoble)

Co-Chairman:

Laurent BARREAU (ST Microelectronics Tours)
Franck DOSSEUL (MODULEUS)

Membres:

Lars BOETTCHER (FRAUNHOFER Institute)
Cyril BUTTAY (AMPERE Laboratory)
Guillaume CALLERANT (SONCEBOZ)
Jean-Luc DIOT (PRIVATE)
Sébastien JACQUES (GREMAN Laboratory)
Guo-Quan LU (VIRGINIA TECH)

Le premier appel à papier vient être envoyé sur une couverture nationale, européenne et internationale comptabilisant plus de 2000 adresses courrielles. Mais le succès de ces appels vient également de vos réseaux respectifs, n'hésitez pas à relayer l'information.

Pour rappel sur le contenu de l'appel à papiers :

We invite speakers to submit abstracts relating to the following topics:

- Power management for transportation and industrial systems
- Energy harvesting systems, from nano to macro (smart grid, wind energy, photovoltaic, etc...)

- Energy conversion systems– from power to emission (lighting, ultrasonic, infrared, etc...)

These topics could be developed around several themes, such as:

- New materials and substrates dedicated to power electronics
- Thermal or thermo mechanical or regulatory constraints (RoHS regulation, REACH, etc...)
- Dedicated technologies for integration and optimization of power systems, including passive components (weight and size reduction, yield improvement, efficiency, etc...)
- Innovative technologies, materials and processes dedicated to interconnection and packaging (die attach, bonding wire & ribbon wires, 3D power components, etc...)
- Reliability and failure modes (impacts linked to technologies, thermal constraints, radiation, etc...), predictive methods, design of experiments, reliability
- High current and high voltage or extremely high voltage: impact on packaging technologies

Dates clés POWER 2023

Appels à papiers : Avril 2022

Sélection des papiers : Septembre 2022

Notification des orateurs : Octobre 2022

Programme : Octobre 2022

IMAPS-France

16th European ATW on Micropackaging and Thermal Management 8 et 9 Mars 2023

Futuroscope de Poitiers

**Jean-Yves Soulier- Safran Data
Systems – Président de la conférence**



Hotel Mercure

Comité Technique :

Mohamad ABO RAS (BERLINER NANOTEST)

Jacques FAVRE (aPSI^{3D})

Dave SAUMS (DS & A LLC)

Thomas HARDER (ECPE)

Jean-Pierre FRADIN (ICAM)

Sandrine LELONG-FENEYROU (Safran Data
Systems)

Bruno LEVRIER (BRUNO LEVRIER
EXPERTISES)

Raphael SOMMET (LABORATOIRE XLIM,
Université de Limoges)

Vincent AYEL (ISAE-ENSMA, Université de
Poitiers, CNRS)

Notre Chairman Jean-Yves Soulier étant en convalescence ce printemps, un trio, composé de JP Fradin, S. Lelong-Feneyrou et B. Levrier reprend l'organisation du 16^{ème} Workshop. Autre changement provisoire, le lieu du Workshop de l'édition 2023 sera l'hôtel Mercure du Futuroscope de Poitiers. Ce choix du Futuroscope nous permet aussi, pour cette année, de mettre en place une collaboration avec l'école d'ingénieurs de l'ISAE-ENSMA basée à proximité du Parc d'Attraction du Futuroscope. L'ATW 2023 offrira donc l'opportunité à de jeunes talents de découvrir les métiers de l'électronique pour lesquels la problématique de la thermique devient plus que jamais critique avec l'électrification accrue de nos modes de transport et les conséquences des derniers chocs géostratégiques.

La très forte tension sur les chaînes de valeur et d'approvisionnement de l'industrie et plus particulièrement de l'industrie

microélectronique représente le défi le plus important depuis le choc pétrolier de 1973. Production et distribution d'électricité vont se faire en plus forte quantité avec moins de matériaux disponibles mais aussi avec un rendement encore meilleur. Dans ces conditions, l'ATW 2023 amènera une pierre à cet édifice dans une perspective de relance de l'industrie électronique en Europe.

L'édition 2023 pourra relancer les échanges (en présentiel) entre les différents acteurs académiques et industriels de notre domaine de prédilection et faire émerger des nouvelles idées et de nouveaux partenariats. Nous continuons donc à assurer la pérennité d'un congrès reconnu pour son expertise technologique et par son contenu riche, et cela en évoluant dans un environnement avec de très fortes contraintes.



ISAE-ENSMA

Pour rappel, les sessions sont :

1. Cooling systems (Jean-Pierre Fradin / Jean-Yves Soulier)
2. Power Electronics (Jean-Yves Soulier)
3. Characterization & Tests (Mohamad Abo Ras)
4. Materials (Boguslaw Wiecek / David Saums)
5. Innovative Cooling Solutions (Jean-Yves Soulier / David Saums)
6. Modeling (Bruno Levrier / Jean Pierre Fradin)

Dates clés THERMAL 2023

Appels à papiers : Mai 2022

Sélection des papiers : Octobre 2022

Notification des orateurs : Novembre 2022

Programme : Décembre 2022

L'équipe Thermal 2023

smartsystems integration

We are happy to announce that the Smart Systems Integration Conference 2022 will take place in presence on

April 27-28, 2022, in Grenoble (France) at Centre de Congrès Maison MINATEC

The program of the conference and details regarding accommodation can be found on the [event website](#).

Please do not hesitate to contact us if you have any further questions.

We look forward to meeting you in Grenoble!

Best regards,
EPoSS Office

Renaud de Langlade, Board Member
EPoSS e.V., Steinplatz 1, 10623 Berlin, Germany

Tel. +49 30 310078 – 5629

Fax +49 30 310078 – 225

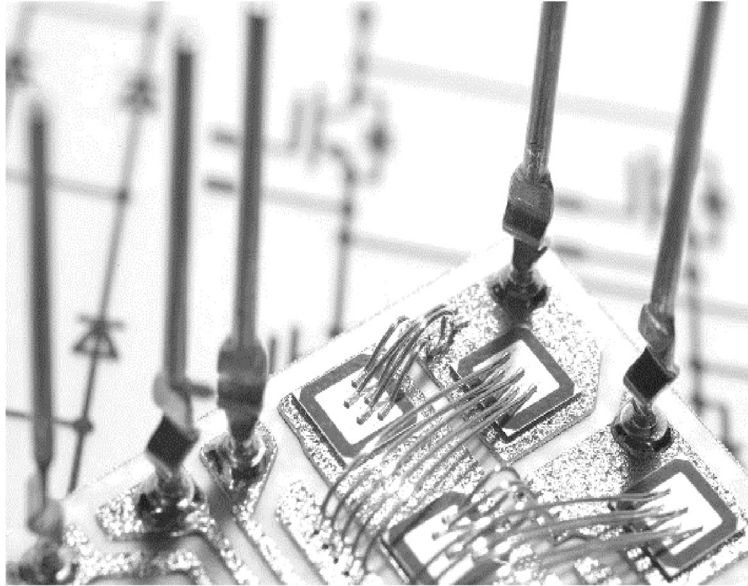
contact@smart-systems-integration.org

[Follow EPoSS on LinkedIn](#)



Conference partners





International Workshop on Integrated Power Packaging (IWIPP 2022)
24-26 Août 2022, World Trade Center, Grenoble
Format hybride (présentiel ou distanciel possible)
Plus d'informations <http://iwipp.org/>

L'objectif de cet événement est de **rapprocher les chercheurs** travaillant sur les composants de puissance, les matériaux d'isolation, les technologies de packaging pour favoriser le développement et la mise sur le marché de convertisseurs de puissance à haute densité et haute efficacité énergétique.

IWIPP adresse notamment les sujets suivants :

- Intégration système et optimisation
- Modélisation et simulation
- Matériaux et technologies de packaging
- Composants et modules à semiconducteurs
- Circuits de commande
- Gestion thermique et packaging 3D
- Compatibilité électromagnétique
- Composants magnétiques haute fréquence
- Isolants haute température et haute tension
- Analyse de fiabilité et prédiction de durée de vie

ACCELONIX et TRESKY sont heureux de vous annoncer leur partenariat.

ACCELONIX, société indépendante et fournisseur de solutions d'équipements et logiciels pour l'assemblage et le test des cartes électroniques et microélectronique, est reconnue par ses clients pour son savoir-faire, son expérience et son sens du service. Établie depuis 1993, ACCELONIX (Anciennement BSE, 1984) n'a de cesse d'améliorer son savoir et son expertise et d'élargir son offre afin de faire face à l'évolution rapide des technologies.

Depuis plus de 40 ans, TRESKY propose des systèmes de pick & place (DIE ATTACH), simple, de haute précision, facile d'utilisation et évolutif. La gamme de ces équipements s'étend des machines manuelles à semi-automatiques.

De nombreuses options pourront faire évoluer votre équipement dans le temps et suivant vos besoins. Aussi, un laboratoire de développement pourra vous accompagner pour la mise en place de vos process.

Avec près de 2500 appareils installés à travers le monde, souvent des équipements personnalisés de très haute précision, TRESKY se place parmi les leaders de sa catégorie.

C'est donc tout naturellement qu'ACCELONIX et TRESKY ont décidé d'unir leurs forces pour vous proposer une gamme de produits complémentaires aux équipements déjà proposés dans le catalogue ACCELONIX.

ACCELONIX et TRESKY se réjouissent de pouvoir vous accompagner dans vos défis actuels et futurs.

LA GAMME TRESKY

L'ensemble de la gamme Tresky intègre la technologie de pose dites « True Vertical ».

T-4909-AE

Système de Die Attach manuel typé R&D, elle est équipée d'un bras Z manuel couplé à un capteur de force. Elle permet de satisfaire au besoin de laboratoire pour des opérations de placement simple ou plus complexe. Un « dispenser » est intégré à la machine. Des options sont disponibles pour des opérations plus complexes.

T-5100 & T-5100-W

Système manuel, sa caméra de contrôle vous permet de réaliser des placements de hautes précisions, la version -W vous permet de prendre vos puces directement depuis un Wafer avec l'éjecteur pneumatique automatisé.

T-5300 & T-5300-W

Système semi-automatique de très haute précision (inférieur au micron), le bras Z motorisé avec capteur de retour de force permettra une multitude d'application, l'ensemble des paramètres et des profils sont contrôlés par un PC permettant un suivi du process de façon simple, robuste et répétable. Les options proposées permettront de couvrir tous types de processus. La version -W vous permet de prendre vos puces directement depuis un Wafer avec l'éjecteur motorisé.

T3000-PRO-HF et T-3002-PRO-HF

Version semi-automatique, elle permet un contrôle de la force jusqu'à 500 N. La version 3002 s'accompagne de l'option d'éjection depuis un Wafer.

Depuis le 1^{er} mars 2022, **METRONELEC** a le plaisir de distribuer la marque **MRSI SYSTEMS** en France, au Maroc et en Tunisie.

MRSI SYSTEMS propose des solutions d'assemblage de puces sur substrats. Ces machines de placement automatique offrent une grande précision et rapidité de production aussi bien pour les composants microélectroniques qu'optoélectroniques.

Applications :

- Communication Optique (Modules 5G)
- Radio-fréquence (RF)
- Medical et capteurs
- Automobile (LIDAR)
- Spatiale et Défense

Technologies d'assemblage :

- Assemblage Eutectique
- Dispense de colle Epoxy
- Assemblage UV
- Assemblage par Flip Chip
- Assemblage par Thermo-compression



TOUT en 1

FLEXIBILITE :

Large surface de travail configurable
Configurable pour Haute Cadence et Volume

PERFORMANCE :

Contrôle de la force en continu / Système de vision évolué /
Eclairage multi couleur programmable /
Précision de placement de 0,5µm à 5µm

FACILITE D'UTILISATION :

Interface conviviale
Programmation des applications simples

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.metronelec.com ou contactez-nous par mail à l'adresse contact@metronelec.com

Teledyne e2v Semiconductors inaugure la fin des travaux de la phase 1 de sa salle blanche d'assemblage et de test.



Moins d'un an après la pose de la première pierre, la phase 1 des travaux de refonte de la salle blanche d'assemblage et de test du site de Saint Egrève sont terminés.

Teledyne e2v semiconductors est concepteur et fabricant de composants et systèmes électroniques haute performance et haute fiabilité. Ses produits, microprocesseurs, convertisseurs de données, et ses solutions d'imagerie sont commercialisés dans le monde entier, pour des applications industrielles, spatiales, médicales et pour le secteur de l'avionique civile et militaire.

La refonte de la salle blanche datant de 1989 permettra l'optimisation des flux de production en conservant le principe du lean manufacturing pour garantir notre compétitivité.

Le lean manufacturing est une méthode d'organisation de la production visant à

augmenter la capacité en réduisant les gaspillages et les temps de cycle à partir de la compréhension du besoin des clients.

Cette nouvelle salle blanche réduit significativement notre impact environnemental avec une salle économe en énergie, est modulable pour préparer l'arrivée de futures technologies et offre une qualité de vie au travail améliorée aux salariés.

La première phase du projet GECKO (Growth Efficiency by Cleanroom Optimization, Croissance et Efficacité par optimisation de la salle blanche) concerne la première moitié de la nouvelle salle de 1200 m² (2000 m² pour l'ancienne salle).



Une nouvelle centrale de traitement d'air neuf (CTAN) a été installée ainsi qu'une batterie de récupération des calories, les automates de contrôle et d'alerte des installations ont été changés, les équipements ont tous été transférés et qualifiés sans interruption de la production. Les travaux concernant la deuxième moitié de la salle démarrent en Avril et dureront un peu plus d'un an.

BULLETIN D'ADHESION 2022

- ☛ 100 € pour les membres individuels en activité.
- ☛ 50 € pour les membres retraités.
- ☛ 20 € pour les membres privés d'emploi, étudiants
- ☛ 650 €*HT Adhésion Société

Date Signature

Mme Mr Numéro AdhérentA020.....
NomPrénom.....
Société
Fonction
Adresse
Code Postal Ville Pays
Tel Email

Adhésion Individuelle :

- Tarif réduit sur tous les événements IMAPS (Europe, Etats-Unis), journée technique, salon MiNaPAD, workshops, salons européens EMPC
- Tarif réduit sur toutes les publications achetées à l'IMAPS.
- Accès à tous les espaces « Members Only » du site web IMAPS et à la base de données « Proceedings »
- Droit de vote pour les élections IMAPS.

Adhésion Société :

- *Tarif IMAPS membres pour tout représentant de votre société pour les conférences organisées par IMAPS France.
- 6 personnes de votre société identifiées comme membre IMAPS individuel reçoivent l'ensemble des publications d'IMAPS
- Accès illimité à l'Espace membres et à la base de données « Proceedings »
- Droit de vote aux Assemblées générales (6 voix).

Inscription et paiement en ligne: www.france.imapseurope.org

MODALITES DE REGLEMENT

Carte bleue

Virement bancaire : Crédit Lyonnais Agence Versailles Saint Louis IBAN FR 49 3000 2089 4800 0007 9088 G25. BIC : CRLYFRPP

Chèque à l'ordre de IMAPS- France, accompagnant le bulletin d'adhésion.

Adresse postale pour l'envoi de chèque :

IMAPS France
A l'attention de monsieur Jean-Yves SOULIER
66, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris

Une facture vous sera adressée. La cotisation société est déductible des impôts de votre société (versement à une association).